

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2026-005

深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,845,658 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德明利	股票代码	001309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于海燕	李格格	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2401	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2401	
传真	无	无	
电话	0755-23579117	0755-23579117	
电子信箱	dml.bod@twsc.com.cn	dml.bod@twsc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主营业务

公司是一家专业存储控制芯片及解决方案提供商，核心能力源于自主可控的存储主控芯片与固件方案研发，及其产业化应用的长期深耕。公司经过多年积累，构建了“硬科技+软服务”的双轮支撑体系，掌握了自主可控的主控芯片研发核心技术，同步形成固件解决方案及量产优化工具核心技术，夯实解决方案的技术根基。在此基础上，公司持续深化“从底层技术到终端场景”的全链路布局，推动业务模式从单纯产品销售逐步向场景化、定制化解决方案转型升级，使存储模组成为解决方案落地的重要载体，为客户提供一站式、全链路存储解决方案服务。

公司产品线涵盖固态硬盘类、嵌入式存储类、内存条类及移动存储类四大系列，已广泛应用于数据中心、手机、车载电子、PC、平板、安防监控等多元应用场景。同时，公司以客户场景为中心，结合系统设计硬件工程、创新优化固件算法、深度挖掘介质应用等方式，实现晶圆颗粒与特定应用场景的敏捷适配，保障数据存储的稳定性、安全性和兼容性，在满足产品性能、可靠性、QoS 等指标的基础上，持续提供增值特性服务，持续为全球 100 多个国家和地区的客户提供定制化、高品质、高性能的存储产品和解决方案。



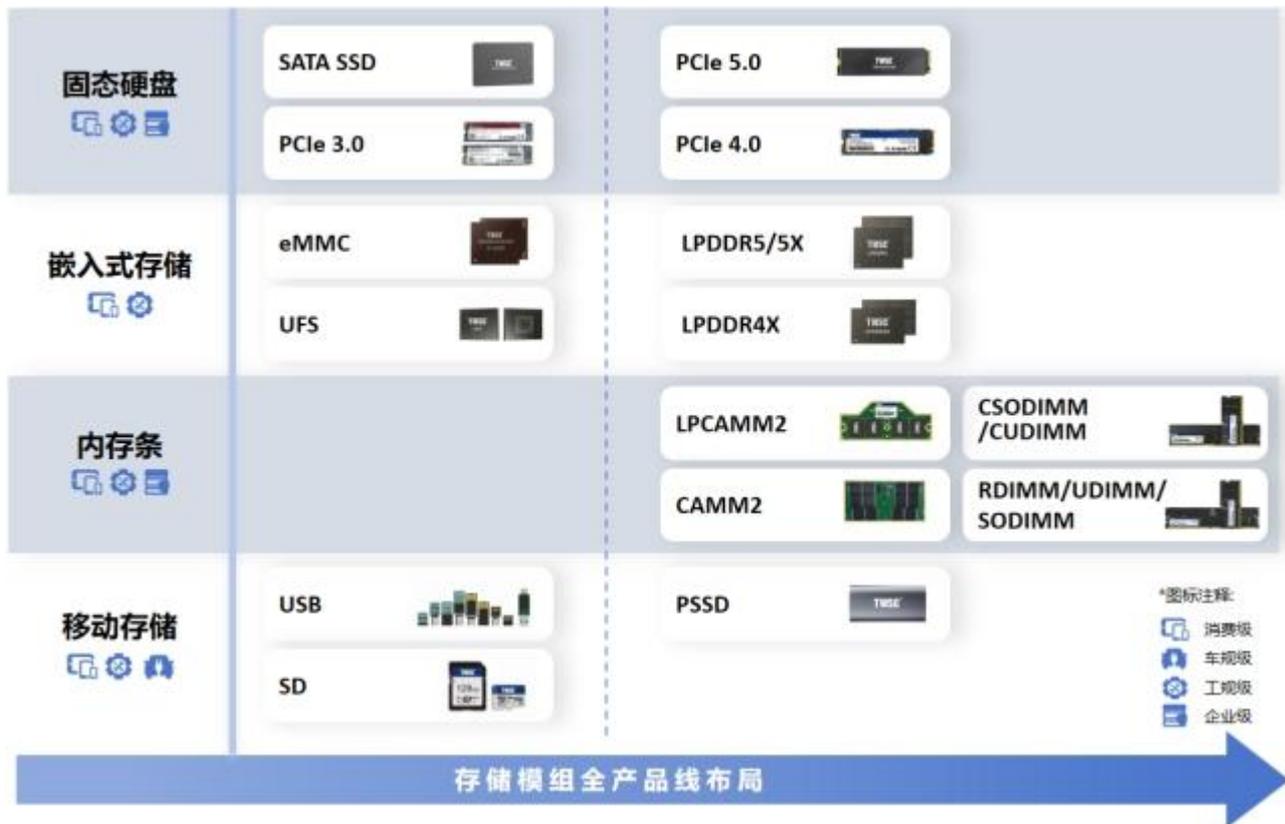
(二) 主要产品

公司的存储业务均系基于存储技术的研发与应用，以闪存主控芯片的设计、研发为差异化核心竞争力，结合固件方案及量产工具开发、存储模组测试和供应链管理等形式形成完善的存储解决方案，最终通过存储模组产品形式实现销售。

在“聚焦存储”战略指导下，公司不断完善存储产品矩阵，拓展产品应用领域与应用场景，目前已经形成了包括固

态硬盘、嵌入式存储、内存条和移动存储在多条存储产品线。在消费级市场，公司通过自研主控、自建测试与生产线，形成具备市场竞争力的固态硬盘、嵌入式存储、内存条、移动存储等存储产品；在数据中心、信创金融、工控安防等应用领域，公司聚焦场景需求，灵活、高效调整主控与固件方案，为客户提供高品质、定制化的存储解决方案。

公司持续推动研发创新，产品矩阵快速拓展，具体情况如下：



1. 固态硬盘

固态硬盘使用固态存储芯片阵列制成，它的出现满足了大容量存储应用场景需求，被广泛应用于 PC、数据中心、人工智能、工控、安防、网络终端、医疗、航天、军工等诸多领域。公司目前拥有 2.5 寸、M.2、U.2、E3.S 等多种形态的 SSD 系列产品，接口上支持 SATA 和 PCIe 协议。产品采用原厂提供的优质 NAND Flash 资源，结合定制化高性能主控和自主固件，在保证兼容性和稳定性的同时，也可实现各类客制化需求。

固态硬盘能够显著提升台式机、笔记本等个人和商用电脑的性能，在数据中心和企业级应用领域更能展现其强大性能。AI 浪潮下，公司正加快向大容量、高性能固态硬盘产品拓展，重点聚焦于 QLC NAND 的企业级应用方向、同时积极拓展固态硬盘在工控、安防等领域应用。公司前瞻性地布局 QLC NAND 相关关键技术，包括针对 QLC NAND 介质特性开发的新一代纠错算法、介质数字信号处理算法、数据压缩技术、低功耗设计等，且公司新一代主控均高效支持 QLC NAND，实现 QLC 产品在性能、耐用性上有效提升。目前，公司已经具备了成熟的 QLC NAND 商业应用能力，并已经实现量产销售。

针对台式机、笔记本等个人和商用电脑市场，公司积极拓展 OEM 客户渠道，目前已成功进入多家知名厂商供应链，部分客户已经实现批量出货，后续将持续深化与主流 PC 厂商的协同，推动多个存储产品在消费级及商用 PC 客户端的协同销售。企业级 SSD 方面，公司依托优秀的企业级研发和测试团队，通过完善的硬件工程设计、创新的固件算法优化、深度的介质应用挖掘等方式，在满足产品性能、可靠性、QoS 等指标的同时，持续为客户提供增值特性服务。

报告期内，公司一方面积极挖掘云服务厂商客户的差异化需求，在存储技术应用上深度合作，推出定制化存储解决方案，推动销售规模快速增长，另一方面针对更广泛的 AI 服务器和数据中心存储增长需求，公司基于自研固件与方案设

计，推出了自有品牌企业级存储系列产品，满足企业级存储客户群体的应用部署需求。此外，面对国产化趋势，公司发挥技术优势，已经推出了固态硬盘的国产化方案，覆盖数据中心、信创金融、工控安防、消费电子等领域，未来将持续加快国产化平台认证导入进程，助力 SSD 国产化进程。

面对智能制造、智慧交通、能源电力、网络通信等战略领域的高价值工控应用场景，公司聚焦工业存储的严苛要求，推出定制化行业解决方案。该方案以“主控芯片+固件算法+定制服务”的全栈技术架构为核心，在具备宽温、抗硫化、防尘、抗冲击、抗压等核心可靠性指标的基础上，针对细分场景需求提供差异化技术支持：例如为边缘计算设备定制低延迟、高耐久的存储方案，确保数据实时处理的响应速度与长期擦写寿命；为 5G 基站、电力监控设备开发抗电磁干扰、长寿命的存储方案，保障复杂电磁环境下的稳定运行。通过深度理解工业客户在可靠性、稳定性与定制化方面的核心诉求，公司构建了从单一硬件到系统级的全链条解决方案能力，形成技术壁垒鲜明的市场竞争力。

报告期内，搭载公司自研 SATA SSD 主控芯片的固态硬盘模组产品已经完成了客户导入工作，并实现批量销售，覆盖工业控制、金融设备终端等各类下游应用领域。在相关应用领域的固态硬盘产品矩阵构建上，公司形成了覆盖 SATA III、PCIe 等主流接口，以及 2.5 寸、mSATA、M.2 等多元形态的全场景产品布局，可适配工控机、服务器、嵌入式设备等多样化硬件平台，实现从 8GB 到 8TB 的全容量段覆盖，满足不同工业场景的存储容量需求。

2. 嵌入式存储

嵌入式存储广泛应用于智能终端，如智能手机、平板、智能电视、机顶盒等。近年来，随着智能网联汽车、人工智能与边缘计算的快速发展，其应用场景已延伸至自动驾驶辅助系统（ADAS）、AI 学习机、智能车载娱乐系统（IVI）、行车记录仪、AR/VR 设备及各类 AI 终端，成为支撑智能化演进的关键基础设施。

嵌入式存储领域对成本效益、供应稳定、产品全生命周期服务有着较高的要求。公司紧密围绕智能终端与新兴应用布局，持续加强研发与业务团队建设，积极拓展消费电子与工控市场。为全面覆盖不同市场的需求，公司构建了完整的嵌入式存储产品矩阵，开发了具备高耐久、宽温域等特性的相关产品，可应用于工业控制、安防监控等场景。公司基于 eMMC、UFS、LPDDR 等主流协议，通过灵活的闪存与主控方案组合以及内存方案组合，在性能与成本之间取得最佳平衡，并依托完善的供应链管理体系，在保障稳定供应的同时，为客户提供贯穿产品全生命周期的可靠服务。

在工控安防等应用场景存储领域，公司产品矩阵已经涵盖 eMMC、UFS、LPDDR 等核心品类，针对工业应用的严苛环境特性，同样完成了宽温域适应性、抗硫化设计、定制化固件优化等关键技术升级，确保在电力设施、网络安全设备、数据通信设备等高可靠性要求场景下实现 7×24 小时稳定运行。产品设计充分考虑工业应用的复杂性，通过优化存储颗粒控制算法与硬件电路布局，有效提升数据读写的一致性与抗干扰能力，满足工业终端设备在高温、高湿、强振动等极端条件下的长期可靠存储需求。

针对高速、大容量的应用，特别是端侧 AI 应用场景，公司推出了多款 LPDDR、UFS、eMMC 产品并不断优化创新。公司 LPDDR 产品线已经覆盖了 LPDDR4X、LPDDR5/5X 系列规格。报告期内，公司 LPDDR4X、LPDDR5/5X 产品已经实现量产出货，能够满足 AI 终端的高速存储需求。报告期内，公司还推出了小尺寸 eMMC、UFS 产品，更好地适配智能穿戴终端使用场景的小型化、低功耗要求。未来公司将加快相关产品研发工作。此外，公司 eMMC 存储产品也已完成和紫光展锐、瑞芯微等国产 SoC 平台深度适配，并在 5G 智能终端、物联网领域应用中取得重大的市场拓展。

在技术演进方面，公司围绕 QLC 在 AI 终端时代的应用，积极推动嵌入式存储产品 QLC 颗粒搭载。报告期内，公司推出了 QLC eMMC 方案，容量覆盖 128GB 至 512GB，支持包括 LDPC 在内的多项技术，以兼顾成本、容量与可靠性需求。此外，公司已规划 QLC UFS 方案，容量范围覆盖 128GB 至 1TB，以应对未来更高性能与更大容量的应用趋势。

3. 内存条

内存条广泛应用于个人电脑、服务器、工作站、商用终端等设备，随着人工智能、云计算和大数据技术的快速发展，个人电脑、数据中心和云服务器对高速、大容量内存的需求日益增长。

公司已经组建了内存条产品线相关团队，主要类型分为 LPCAMM2、CAMM2、RDIMM、SODIMM 和 UDIMM 等。为快速实现高质量产品的批量交付，公司内存业务与研发团队在高效完成产品设计与方案开发的同时，着手研发并部署了内存产品

测试设备，保障产品可靠性与兼容性，依托现有客户资源实现市场快速突破。

针对 AI 应用与工控场景，研发团队不仅在硬件设计上改进散热设计、添加电源管理系统，快速跟进新型外型尺寸与接口，更新增温度管理、自适应电压调节、动态频率调整等功能。公司内存产品线已经依托自研的内存测试算法和内存硬件布局，构建了一个从预防到检测的完整闭环，有效保证产品的功能完整性和性能一致性，保障在重载、不间断业务场景下的稳定运行。未来，公司将持续拓展 LPCAMM2 等新品，强化存储性能与服务质量（QoS）保障。

报告期内，公司消费级内存已经开始量产出货，加快行业客户、品牌终端客户产品送样与验证工作。公司内存条已成功进入多家知名厂商供应链，部分客户已经实现批量出货，后续将持续深化与主流 PC 厂商的协同，推动多个存储产品在消费级及商用 PC 客户端的协同销售。报告期内，公司推出了 DDR5 RDIMM 产品，频率 5600 - 6400 MT/s，容量 32GB-96GB，覆盖主流企业级服务器与工业应用需求。

4. 移动存储

移动存储作为传统存储类型，因其技术成熟且具有低功耗、低成本等特点，在数据备份、文件传输、移动终端等场景大量应用。而随着存储原厂晶圆制造技术快速迭代，存储密度不断提高，移动存储也迎来更多应用场景落地机会，特别是在视频监控、工业控制等不断增长的细分领域。为针对不间断录制环境下高写入数据量存储需求，公司新一代 SD 卡主控芯片采用创新架构设计，支持 144/176 层乃至更高层的 3D TLC/QLC NAND，支持 4K LDPC 技术与 ONFI 4.0 协议，通过优化的固件方案与智能算法，实现写放大降低和动态磨损平衡，提升产品兼容性与耐久性，该芯片采用低功耗设计，支持生产环境下的预测性维护与能耗管理，全面满足工业存储的可靠性与能效要求。

1) 存储卡模组

存储卡是一种利用闪存技术存储数据信息的存储器，其尺寸小巧，外形多为卡片形式，主要应用于手机、GPS 设备、数码相机、无人机、安防摄像头、智能音箱、电子游戏机等消费电子产品中作为存储介质。此外，公司进一步开发了具备宽温和高耐久特性的存储卡产品，可适用于车载监控、行车记录仪、中控导航、灾备盒、部标机等对产品稳定性要求较高的复杂环境。

公司存储解决方案广泛支持长江存储、三星电子、海力士、美光等各家存储原厂的相关存储晶圆产品，并高效实现对 NAND Flash 存储颗粒的数据管理和应用性能提升，进一步扩展存储卡模组产品的兼容性、提高存储卡的读写速度、稳定性以及降低整机产品功耗等。搭载公司新一代自研 SD6.0 存储卡主控芯片的存储模组已经完成产品开发，并实现批量出货。

报告期内，公司积极丰富存储卡下游应用领域，加快拓展下游客户类型，加快移动存储产品在车载电子、行车记录仪、工控设备等领域拓展，实现了规模销售。

2) 存储盘模组

存储盘（U 盘）是一种通过 USB 接口进行数据传输，利用 NAND Flash 存储芯片进行存储的可移动数据存储装置，目前已经成为人们日常生活中最常用的移动存储介质之一。公司存储盘模组产品方案具有较好的性能和成本优势以及广泛地支持三星电子、铠侠、西部数据/闪迪、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
--	---------	---------	-----------	---------

总资产	10,850,236,045.46	6,568,159,107.56	65.19%	3,288,196,110.77
归属于上市公司股东的净资产	3,269,412,791.23	2,480,378,428.99	31.81%	1,122,034,573.15
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	10,789,100,246.68	4,772,546,275.05	126.07%	1,775,912,799.26
归属于上市公司股东的净利润	688,329,031.23	350,553,740.48	96.35%	24,998,465.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,252,027.89	302,698,112.09	120.77%	14,936,707.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,240,893,168.11	-1,263,366,719.31	-77.37%	-1,015,413,532.56
基本每股收益（元/股）	3.08	1.70	81.18%	0.12
稀释每股收益（元/股）	3.03	1.69	79.29%	0.12
加权平均净资产收益率	24.21%	26.83%	-2.62%	2.26%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,252,045,531.07	2,856,991,056.21	2,550,073,103.46	4,129,990,555.94
归属于上市公司股东的净利润	-69,087,664.28	-48,857,962.68	90,869,116.27	715,405,541.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,958,564.66	-47,396,681.88	71,873,673.62	718,733,600.81
经营活动产生的现金流量净额	-497,231,240.59	-92,812,202.70	-904,523,497.57	-746,326,227.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,270	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李虎	境内自然	35.01%	79,410,129	63,146,007	质押	8,050,000	

	人					
魏宏章	境内自然人	4.09%	9,283,157	0	质押	3,000,000
中信银行股份有限公司—永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	2.03%	4,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	3,319,648	0	不适用	0
广发证券资管—贺伟—广发资管申鑫利 71 号单一资产管理计划	其他	1.00%	2,264,650	0	不适用	0
泰安金程源企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	1,940,864	0	不适用	0
广发证券资管—贺伟—广发资管申鑫利 70 号单一资产管理计划	其他	0.74%	1,681,339	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.70%	1,581,302	0	不适用	0
广发证券资管—徐岱群—广发资管申鑫利 88 号单一资产管理计划	其他	0.68%	1,546,291	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.66%	1,500,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广发证券资管—贺伟—广发资管申鑫利 71 号单一资产管理计划、广发证券资管—贺伟—广发资管申鑫利 70 号单一资产管理计划的认购人贺伟，与广发证券资管—徐岱群—广发资管申鑫利 88 号单一资产管理计划的认购人徐岱群，二人系夫妻关系，贺伟与徐岱群认购的资产管理计划合计持有公司股份 2.42%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	广发证券资管—贺伟—广发资管申鑫利 71 号单一资产管理计划通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,262,700 股；广发证券资管—贺伟—广发资管申					

鑫利 70 号单一资产管理计划通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,614,439 股；广发证券资管—徐岱群—广发资管申鑫利 88 号单一资产管理计划通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 687,310 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

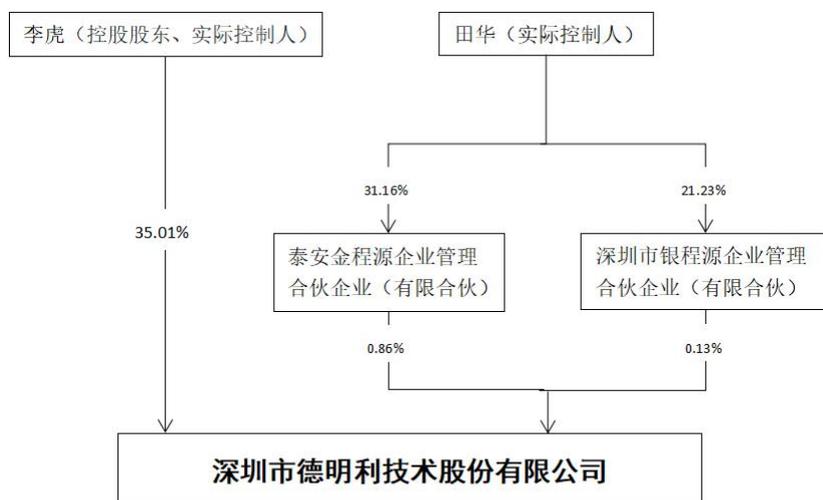
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：(1) 本框图统计时间截至 2025 年 12 月 31 日止；

(2) 实际控制人田华通过金程源间接持有公司股份 0.27%，通过银程源间接持有公司股份 0.03%，合计共同间接持有公司股份 0.3%。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司于 2024 年 1 月 15 日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，对以上文件进行了修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件；2024 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，及于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董

事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案；2024 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，对相关文件再次进行了第二次修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件；2024 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，对相关文件再次进行了第三次修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关文件。

2024 年 10 月 10 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2024 年 11 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请，后续公司将在 12 个月内严格按照报送深交所的申报文件和发行方案实施本次发行。

2024 年 12 月 24 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件经深交所备案通过。

2025 年 1 月 23 日，公司完成向特定对象发行股票登记并上市的工作。

2、通过海关 AEO 高级认证企业资质认证

公司于 2025 年 1 月取得深圳海关颁发的 AEO 高级认证企业证书。AEO 认证是中国海关对企业信用管理的最高等级认证，被誉为开展国际贸易的“金字招牌”，AEO 企业可享受互认国家双方海关的“国际最认可、国内最优惠、通关最便利”等多维度优惠措施，公司全球通关效率再提速。公司将以通过 AEO 认证为契机，依托高效的内控体系，提升风险管控能力与运营效率，提升国际物流效率，优化供应链体系，为全球客户提供了更高效、更可靠的全球交付服务。

3、公司章程与注册资本的变更

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议、于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，公司于 2024 年 7 月 2 日完成《公司章程》的修改和公司注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本变更为 147,512,976 元。

2024 年 6 月 20 日，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共 73,255 股，公司注册资本由原人民币 147,512,976 元变更为人民币 147,586,231 元。

2024 年 10 月 14 日，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票完成登记上市，本次登记上市股份数共 1,114,700 股，公司注册资本由原人民币 147,586,231 元变更为人民币 148,700,931 元。

2024 年 11 月 21 日，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共 43,953 股，公司注册资本由原人民币 148,700,931 元变更为人民币 148,744,884 元。

2024 年 11 月 27 日，公司回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记的限制性股票 1,820 股。本次回购注销完成后，公司注册资本由原人民币 148,744,884 元变更为人民币 148,743,064 元。

公司向特定对象发行股票新增股本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记，并于 2025 年 1 月 23 日上市。本次登记上市股份数共 13,029,608 股，本次发行新增股票登记上市后，公司注册资本由原人民币 148,743,064 元变更为人民币 161,772,672 元。

公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二十六次会议、2025 年 2 月 14 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司已根据上述变更事项，向深圳市工商登记管理部门办理完成相应的工商登记变更手续。

2025 年 3 月 25 日，公司回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票 2,366 股，公司注册资本由原人民币 161,772,672 元变更为人民币 161,770,306 元。

2025 年 7 月 10 日，公司实施 2024 年权益分派，公司以总股本 161,770,306 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司注册资本由原人民币 161,770,306 元变更为人民币 226,478,428 元。

2025 年 7 月 31 日，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票完成登记上市，本次登记上市股份数共 411,600 股，公司注册资本由原人民币 226,478,428 元变更为人民币 226,890,028 元。

2025 年 8 月 29 日，公司回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票 1,656 股、公司回购注销 2024 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票 2,100 股。以上共回购注销 3,756 股。本次回购注销完成后，公司注册资本由原人民币 226,890,028 元变更为人民币 226,886,272 元。

公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第二届董事会第三十二次会议、2025 年 9 月 19 日召开了公司 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司已根据上述变更事项，向深圳市工商登记管理部门办理完成相应的工商登记变更手续。

2025 年 12 月 30 日，公司回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 6 名离职人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票 37,534 股、公司回购注销 2024 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票 3,080 股。以上共回购注销 40,614 股。本次回购注销完成后，公司总股本由原 226,886,272 股变更为 226,845,658 股。

4、部分董事、前董事、前监事通过持股平台金程源进行减持

2025 年 1 月 16 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公司股东金程源计划自 2025 年 1 月 17 日起 15 个交易日后的三个月内通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持公司股份合计不超过 800,000 股（占当时公司总股本比例 0.5378%，其中通过竞价交易方式减持不超过 50,000 股）。

2025 年 3 月 5 日，公司披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告》，股东金程源前述减持计划实施完毕。其中，公司前董事叶柏林通过金程源间接持有公司股份 292,575 股，本次减持数量为 73,143 股；公司职工代表董事（前监事会主席）李国强通过金程源间接持有公司股份 568,897 股，本次减持数量为 142,224 股；前监事李鹏和何勇均通过金程源间接持有公司股份 195,051 股，本次减持数量均为 48,762 股。上述 4 人减持数量均达到其通过金程源间接持有公司股份的 25%，其 2025 年度的可减持额度均已使用完毕。

5、控股股东首发限售股解除限售

2025 年 7 月 1 日，控股股东李虎先生所持有的首发前限售股 58,401,775 股解除限售，至此公司首次公开发行前已发行股份已全部解除限售。

6、2024 年度权益分派

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，发布了《2024 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2025-052），以截至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 161,770,306 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派股权登记日为 2025 年 7 月 9 日，除权除息日为 2025 年 7 月 10 日。2025 年 7 月 10 日，本次权益分派实施完毕。

7、2023 年向特定对象发行股票部分限售股上市流通

2025 年 7 月 23 日，公司 2023 年向特定对象发行股票部分限售股解除限售，本次解除限售股份数量为 16,417,307 股。本次发行对象中，除控股股东李虎先生所认购本次发行的股份 1,824,144 股未解除限售外（限售期为 18 个月），其他特定对象所认购本次发行的股份全部解除限售。

8、控股股东、实际控制人减持股份

2025 年 8 月 19 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人李虎先生、田华女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易和大宗交易相结合的方式，合计减持公司股份不超过 5,700,000 股（占当时公司总股本比例 2.51%）。其中李虎先生计划减持不超过 5,480,000 股（占当时公司总股本比例 2.41%），田华女士计划通过银程源减持不超过 220,000 股（占当时公司总股本比例 0.10%）。

2025 年 9 月 23 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告》及《简式权益变动报告书》等，控股股东、实际控制人李虎先生、田华女士前述减持计划实施完毕。本次减持期间，李虎先生共减持公司股份 4,176,500 股，本次减持后持有公司股份数量 79,410,129 股，占公司总股本比例为 34.99997%；田华女士共减持 220,000 股，本次减持后田华女士通过持股平台金程源、银程源间接持有公司 666,038 股，占公司总股本比例为 0.29444%。

9、2025 年股票期权激励计划

2025 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，2025 年 9 月 19 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉》《关于制定公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司拟向激励对象授予股票期权数量为 482.875 万份（其中预留 96.575 万份），首次授予的激励对象总人数为 294 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），授予价格为 80.99 元/份。

2025 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，决定以 2025 年 9 月 22 日为授予日，向符合 2025 年股票期权激励计划授予条件的首次授予的 294 名激励对象授予股票期权 386.3 万份，行权价格为 80.99 元/份。2025 年 11 月 7 日，公司完成上述股票期权登记事项手续。

10、2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期限限制性股票解除限售

2025 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 87 名，可解除限售的限制性股票数量为 613,991 股。2025 年 9 月 29 日，公司完成上述限制性股票解除限售事项手续，上述限制性股票的上市流通日为 2025 年 10 月 9 日。

11、2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票解除限售

2025 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满，解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 75 人，同意公司为此 75 名激励对象办理解除限售相关事宜，解除限售比例为 100%，解除限售股票数量为激励对象已获授全部限制性股票数量的 40%，共计解除限售 622,160 股。2025 年 11 月 7 日，公司完成上述限制性股票解除限售事项手续，上述限制性股票已于 2025 年 11 月 10 日上市流通。

12、回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划限制性股票

2025 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、监事会第二十八次会议，2025 年 7 月 28 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票 1,656 股、公司回购注销 2024 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票 2,100 股，以上共回购注销 3,756 股。2025 年 8 月 29 日，公司完成上述回购注销事项相关手续。

2025 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议，2025 年 10 月 31 日公司召开了 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销了 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 6 名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票共 37,534 股、公司回购注销了 2024 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票 3,080 股。2025 年 12 月 31 日，公司披露了《关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告》，公司完成回购注销 6 名离职人员已授予登记的限制性股票共 40,614 股。

13、投资深圳市盈和致远科技有限公司事项

2025 年 5 月 23 日，公司与陈旭、深圳市盈和同芯投资企业（有限合伙）、深圳市麒正科技有限公司签署《关于深圳市盈和致远科技有限公司的股权转让及增资扩股协议》。报告期内，公司根据协议约定支付了股权转让款 12,560,000.00 元、支付了协议约定的增资款 26,408,163.00 元，共计 38,968,163.00 元。本次股权转让及增资后公司持有盈和致远 51%的股权。根据协议约定，公司在投资后仍由盈和致远原经营管理团队保持对盈和致远的经营、治理等的主导地位，公司对盈和致远不享有控制权。

2025 年 8 月 12 日，公司与陈旭、深圳市盈合同芯投资企业（有限合伙）、深圳市麒正科技有限公司签订《深圳市盈和致远有限公司股东合作协议》，约定为实现盈和致远及股东利益的最大化，同意盈和致远优先以股权转让方式引入新投资方并由德明利向新投资方出让约 20%盈和致远股权，以实现盈和致远股权总体规划。2025 年 12 月 16 日，公司与刘燕平、傅冰、桂晨亮三人分别签署《深圳市盈和致远科技有限公司股权协议》，约定以 1,300.5 万元向三人合计出让盈和致远 64.9469 万元认缴出资份额，对应股权比例 17%。2025 年 12 月，三人已根据协议完成第一期转让价款的支付，合计支付金额 680.0 万元（占总价款比例 52.29%）。2026 年 1 月，三人已根据协议约定完成剩余全部股权转让款的支付，并完成盈和致远的工商变更登记。本次股权转让后，公司持有盈和致远 34%股权，陈旭及一致行动人深圳市盈和同芯投资企业（有限合伙）合计持有股份 40.55%，盈和致远实际控制人未发生变更。

14、公司 2025 年向特定对象发行股票并在主板上市

2025 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议、于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，同时公司披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关文件。

2025 年 12 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，（深证上审（2025）285 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。目前相关事项正在有序推进中。

15、向金融机构申请综合授信及接受关联方担保

（1）2023 年 01 月 10 日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利 2023 固字 01 号的《固定资产贷款合同》，授信总金额为 16,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 8,641.96 万元。

（2）2023 年 12 月 28 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 SX2312223802 号的《综合授信合同》，授信总金额为 10,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(3) 2024 年 03 月 21 日, 公司与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行签订了编号为 81200202400021874 号的《最高额综合授信合同》, 授信额度为 8,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(4) 2024 年 03 月 22 日, 公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利 2024 综字 01 号的《综合授信合同》, 授信总金额为 20,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(5) 2024 年 03 月 26 日, 公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深中德明利授信字(2024)第 001 号的《额度授信合同》, 授信额度为 20,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(6) 2024 年 04 月 26 日, 公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 2024 深银观澜综字第 0004 号的《综合授信合同》, 授信额度为 30,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 29,700.00 万元。

(7) 2024 年 04 月 29 日, 公司与宁波银行股份有限公司深圳分行续期了编号为 07300LK23C5AMDC 号的《线上流动资金贷款总协议》, 授信额度为 20,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 9,000.00 万元。

(8) 2024 年 05 月 16 日, 公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 0914547 的《综合授信合同》, 授信额度为 20,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(9) 2024 年 05 月 23 日, 公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了编号为华银(2024)深综字(深圳湾)第 0523 号的《综合授信合同》, 授信额度为 15,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(10) 2024 年 06 月 25 日, 公司与民生银行股份有限公司深圳分行签订了编号为公授信字第罗湖 24002 号的《综合授信合同》, 授信额度为 30,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(11) 2024 年 06 月 25 日, 公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了编号为平银前海二综字 20240620 第 01 号的《综合授信额度合同》, 授信额度为 20,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(12) 2024 年 06 月 26 日, 公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为(33100000)浙商资产池字(2024)第 13641 号的《资产池业务合作协议》, 资产池额度最高限额不超过 40,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(13) 2024 年 07 月 29 日, 公司实际控制人李虎、田华与中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别签订编号为 HTC442000000ZGDB2024N0YE 号、HTC442000000ZGDB2024N0YF 号的《本金最高额保证合同》, 为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信 30,500.00 万元提供连带责任保证担保; 2025 年 1 月 13 日, 公司实际控制人李虎、田华与中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别签订编号为 HTC442000000ZGDB2024N213 号、HTC442000000ZGDB2024N214 号的《本金最高额保证合同》, 为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信增加 10,000.00 万元提供连带责任保证担保。截止 2025 年 12 月 31 日, 上述授信借款余额为 33,350.00 万元。

(14) 2024 年 8 月 15 日, 公司与光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 ZH39182407008 的《综合授信协议》, 授信额度为 25,000.00 万元; 2025 年 1 月 21 日, 就上述编号为 ZH39182407008 《综合授信协议》原协议, 签订编号为变 ZH39182407008 的《综合授信协议变更协议》, 将授信额度调整为 35,000.00 万元。此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截止 2025 年 12 月 31 日上述授信借款余额为 0 万元。

(15) 2024 年 8 月 19 日, 公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订了编号为深中小贷(2024)年借字(10245)号的《借款合同》, 授信额度为 6,000.00 万, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 深圳市深担增信融资担保有限公司为公司此笔授信提供保证担保, 此外公司质押了以下 2 个发明专利:①一种兼容移动固态硬盘的结构及移动固态硬盘(专利号为 ZL 2019 1 0898738.7); ②一种基于 FPGA 的闪存数据采集装置和采集方法(专利号为 ZL 2021 1 1541250.2)。截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(16) 2024 年 7 月 26 日, 公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 SZ36(融资)20240007 号的《最高额融资合同》, 授信额度为 20,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(17) 2024 年 8 月 22 日、9 月 20 及 11 月 1 日, 公司与中国进出口银行深圳分行分别签订了编号为 HETO20200001620240800000021 的《借款合同》、编号为 HETO20200001620240800000026 的《借款合同》及编号为深字 2024 年贸金 031 号的《贸易金融授信业务总协议》, 授信额度为 30,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(18) 2024 年 8 月 16 日, 公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为(2024)深银综授额字第 001034 号的《授信额度合同》, 授信额度为 10,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(19) 2024 年 10 月 28 日, 公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行签订了编号为 PSBCSZ05-YYT2024102901 的《流动资金借款合同》, 金额为 9,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 7,875.00 万元。

(20) 2024 年 12 月 10 日, 公司与深圳农村商业银行股份有限公司南山支行签订了编号为 00520202400337 的《授信合同》; 2025 年 8 月 25 日, 公司与深圳农村商业银行股份有限公司南山支行签订了编号为 005202025K00119 的《授信合同》, 授信额度合计为 40,000.00 万元, 上述授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 30,860.00 万元。

(21) 2025 年 1 月 17 日, 公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深新安德明利授信字(2025)第 001 号的《额度授信合同》, 授信额度为 30,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 20,000.00 万元。

(22) 2025 年 1 月 22 日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 BC2024080600001719 号的《融资额度协议》, 授信额度为 30,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(23) 2025 年 2 月 13 日, 公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为 2025 圳中银华额协字第 0013 号的《授信额度协议》、编号为 2025 圳中银华长借字第 0014 号的《流动资金借款合同》, 授信额度为 25,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 19,750.00 万元。

(24) 2025 年 2 月 27 日, 公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利 2025 综字 01 号的《综合授信合同》、交银深德明利 2025 流字 01 号的《流动资金借款合同》, 授信额度为 34,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 28,860.00 万元。

(25) 2025 年 3 月 7 日, 公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为(2025)深银综授额字第 000056 号的《授信额度合同》, 授信额度为 20,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(26) 2025 年 4 月 23 日, 公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了编号为 X202500020 号的《单项借款合同》, 授信额度为 4,000.00 万, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 深圳市深担增信融资担

保有限公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下发明专利：①一种 DRAM 存储器的数据写入方法和 DRAM 控制系统（专利号为 ZL202111361888.8）。截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 4,000.00 万元。

（27）2025 年 5 月 21 日，公司与徽商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为流借字第 20250974-3 号的《流动资金借款合同》，授信额度为 20,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 19,800.00 万元。

（28）2025 年 06 月 16 日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了编号为华银（2025）深综字（深圳湾）第 0609 号的《综合授信合同》，授信额度为 30,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 29,500.00 万元。

（29）2025 年 6 月 24 日，公司实际控制人李虎、田华与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（20925000）浙商银高保字（2025）第 00073 号的《最高额保证合同》，为公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保额度为 33,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 10,000.00 万元。

（30）2025 年 6 月 20 日，公司实际控制人李虎、田华与中国进出口银行深圳分行分别签订了编号为 HET020200001620250600000001-BZ01 号、HET020200001620250600000001-BZ02 号的《最高额保证合同》，为公司向中国进出口银行深圳分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保额度为 55,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 50,000.00 万元。

（31）2025 年 9 月 8 日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 6154594 的《综合授信合同》，授信额度为 30,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 30,000.00 万元。

（32）2025 年 9 月 26 日，公司与光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 ZH3918250914 的《综合授信协议》，授信额度为 60,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 39,920.00 万元。

（33）2025 年 9 月 9 日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 SZ36（融资）20250008 号的《最高额融资合同》，授信额度为 40,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 30,000.00 万元。

（34）2025 年 9 月 22 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 BC2025091500001466 号的《融资额度协议》，授信额度为 30,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 15,000.00 万元。

（35）2025 年 8 月 18 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 HTWB4401000072025000096 号的《综合产品池业务合同》，授信总金额为 30,000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 20,000.00 万元。

（36）2025 年 7 月 30 日，公司与兴业国际信托有限公司签订了编号为 CIIT20250364XTDK 的《信托贷款合同》，借款总金额为 20,000.00 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 20,000.00 万元。

（37）2025 年 8 月 19 日，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订了编号为深中小贷（2025）年借字（00936）号的《借款合同》，授信额度为 6,000.00 万，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下 2 个发明专利：①一种兼容移动固态硬盘的结构及移动固态硬盘（专利号为 ZL 2019 1 0898738.7）；②一种基于 FPGA 的闪存数据采集装置和采集方法（专利号为 ZL 2021 1 1541250.2）。截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 6,000.00 万元。

(38) 2025 年 10 月 23 日, 公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了编号为平银前海二综字 20251016 第 01 号的《综合授信额度合同》, 授信额度为 20,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 19,500.00 万元。

(39) 2025 年 11 月 6 日, 公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行签订了编号为 PSBCSZ05-YYT2025110401 的《流动资金借款合同》, 借款金额为 10,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 10,000.00 万元。

(40) 2025 年 11 月 14 日, 公司实际控制人李虎、田华与中国工商银行股份有限公司深圳分行分别签订编号为 0400000405-2025 年星河(保)字 0228 号、0400000405-2025 年星河(保)字 0229 号的《最高额保证合同》, 为公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请授信 20,000.00 万元提供连带责任保证担保

(41) 2025 年 12 月 17 日, 公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 755XY251217T000196 的《授信协议》, 授信总金额为 30,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 20,000.00 万元。

(42) 2025 年 12 月 25 日, 公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订了编号为渤前分流贷(2025)第 40 号的《流动资金借款合同》, 授信总金额为 30,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 0 万元。

(43) 2025 年 12 月 17 日, 公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为(2025)深银综授额字第 001143 号的《授信额度合同》, 授信额度为 50,000.00 万元, 此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 20,000.00 万元。

(44) 2025 年 5 月 29 日, 子公司源德(香港)有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 2024 深银梅林综字第 00021 号的《综合授信合同》, 授信额度为 10,000.00 万元, 此笔授信由公司及公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 9,900.00 万元。

(45) 2025 年 6 月 17 日, 子公司源德(香港)有限公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了编号为华银(2025)深综字(深圳湾)第 0519 号的《综合授信合同》, 授信额度为 5,000.00 万元, 此笔授信由公司及公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保, 截至 2025 年 12 月 31 日该笔授信借款余额为 5,000.00 万元。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日